

Richtlinien für Design und Abwicklung bei der Erstellung von Beiträgen für den Berliner Kreis Newsletter

Allgemeine Informationen

Umfang: 8 Seiten à DIN A4; zwei Spalten pro Seite
170 mg/ qm Papier glänzend
Auflage: 2.500 Stück
Erscheinungsweise: halbjährlich

Zielsetzung & Inhalt

Das Ziel ist es, den Lesern, die sich aus Persönlichkeiten der Industrie zusammensetzen, in kurzen und prägnanten Texten die wichtigsten Neuigkeiten des Berliner Kreis zu vermitteln.

Die Artikel des BK-Newsletters setzen sich aus verschiedenen Texten zusammen:

- Artikel (Projekte, Kooperationen, neue Buchpublikationen, Tagungsankündigungen),
- Informationen/Termine.

Bitte geben Sie Texte und Bilder in jedem Fall getrennt ab.

Bilder und Grafiken

Um Bilder und Grafiken in einer guten Qualität zu drucken, sollten diese eine Mindestauflösung von 300dpi nicht unterschreiten. Bitte geben Sie Bilder im Format tiff ab, Grafiken im Format cdr.

Bildqualität 300dpi
Format tiff oder cdr

Tipp: Powerpoint-Grafiken lassen sich als Bilder ins tiff-Format exportieren. Diese haben allerdings lediglich eine Auflösung von 96dpi.

Möchten Sie Ihre Bilder oder Grafiken an einer bestimmten Position im Text gesetzt haben, bitten wir Sie um einen entsprechenden Vermerk. Des Weiteren möchten wir Sie bitten uns für jedes eingereichte Bild eine Bildunterschrift mitzuliefern.

Bildunterschrift für jedes eingereichte Bild.

Leitfaden. Berliner Kreis Newsletter

2

Überschriften

Für die Überschrift Ihres Artikels bitten wir Sie, folgende Angaben einzuhalten:

- Überschrift eine Zeile: max. 38 Zeichen inkl. Leerzeichen
- Überschrift zwei Zeilen: max. 75 Zeichen inkl. Leerzeichen

Überschrift max. 75 Zeichen

Unterüberschriften

Bei gewünschten Unterüberschriften oder einem Einleitungstext halten Sie bitte einen Umfang von 160 Zeichen inkl. Leerzeichen ein.

Textformate

Bitte reichen Sie uns Ihre Texte in folgendem Format ein:

- einfacher Zeilenabstand,
- keine erzwungenen Trennstriche,
- Word-Dokument (.doc) oder plain Text (.txt)

KEINE manuellen Trennstriche!

Textumfang

Der BK-Newsletter wird mit einem Raster von zwei Spalten gesetzt. Für Ihren Artikel bitten wir Sie, sich an den folgenden Angaben zum Textumfang zu orientieren.

Textumfang für einen Artikel über eine Seite:

- ohne Bild: max. 4.500 Zeichen inkl. Leerzeichen
- ein Bild: max. 4.000 Zeichen inkl. Leerzeichen
- zwei Bilder: max. 3.500 Zeichen inkl. Leerzeichen
- drei Bilder: max. 3.000 Zeichen inkl. Leerzeichen

Textumfang eine Seite:
ohne Bild - 4.500 Zeichen
1 Bild - 4.000 Zeichen
2 Bilder - 3.500 Zeichen
3 Bilder - 3.000 Zeichen

Textumfang für einen Artikel über eine halbe Seite:

- ohne Bild: max. 2.500 Zeichen inkl. Leerzeichen
- ein Bild: max. 2.000 Zeichen inkl. Leerzeichen

Textumfang halbe Seite:
ohne Bild - 2.500 Zeichen
ein Bild - 2.000 Zeichen

Textumfang bei Bildern, die über die volle Seitenbreite gehen:

- max. 2.500 Zeichen inkl. Leerzeichen

Diese Werte dienen grundsätzlich nur als Richtwerte. Im Sinne eines einheitlichen Designs freuen wir uns, wenn Sie sich an diesen Angaben orientieren.

Geringfügige Abweichungen von etwa 5% über diesen Angaben sind unkritisch.

Selbstverständlich sind auch Beiträge mit einem Umfang von 1,5 - 2 Seiten grundsätzlich möglich. Stimmen Sie sich diesbezüglich bitte im Vorfeld mit der Redaktion ab.

Leitfaden. Berliner Kreis Newsletter

3

Ansprechpartner für Ihren Artikel

Im Anschluss an Ihren Artikel führen wir hier gerne den entsprechenden Ansprechpartner auf. Bitte reichen Sie uns hierzu folgende Informationen ein:

- Lehrstuhlinhaber: Titel, Name, Vorname (Beispiel: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Gausemeier)
- Autor: Titel; Name (Beispiel: Dipl.-Wirt.-Ing. Christoph Peitz)
- Institut (optional) (Beispiel: Heinz Nixdorf Institut)
- Names des Lehrstuhls (Beispiel: Lehrstuhl für Produktentstehung)
- Name der Universität (Beispiel: Universität Paderborn)

Seitentext:
Geben Sie bitte den
vollständigen Kontakt an.

Veranstaltungskalender

Im Veranstaltungskalender des Berliner Kreis-Newsletters werden interessante und für die Institute des Berliner Kreis relevante

Termine zu Messen, Konferenzen und Tagungen veröffentlicht.

Folgende Angaben sind uns hierzu wichtig:

- Termin
- Titel der Veranstaltung
- Veranstaltungsort (Beispiel: Heinz Nixdorf Institut, Paderborn)
- Webseite/E-Mailadresse

Termine

Der BK-Newsletter erscheint zweimal jährlich. Ihre Beiträge können Sie uns jederzeit hereinreichen.

Möchten Sie Ihren Artikel in einer bestimmten Ausgabe platzieren, reichen Sie uns diesen bitte wie folgt ein:

Ausgabe zum 15. April jeden Jahres:

Abgabetermin für Ihren Artikel: 28. Februar d.J.

Ausgabe zum 15. November jeden Jahres:

Abgabetermin für Ihren Artikel: 30. September d.J.

Fixe Abgabefristen:
28. Februar d.J.
30. September d.J.

Die Mitglieder des Berliner Kreis werden per Mail auf diese Fristen aufmerksam gemacht und sind angehalten, diese Informationen an die Mitarbeiter weiterzuleiten.

Rückfragen

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Inhaltliche Fragen & Redaktionsleitung

Christoph Peitz: Christoph.Peitz@hni.uni-paderborn.de
(An diese Adresse senden Sie bitte Ihre Beiträge)

Bildbearbeitung & Satz

Stefanie Hesse: Stefanie.Hesse@hni.uni-paderborn.de

Überschrift:
max. 38 Zeichen
inkl. Leerzeichen



Bei der Entwicklung und Herstellung mechatronischer Erzeugnisse sehen sich Unternehmen steigenden Anforderungen hinsichtlich Miniaturisierung und Rationalisierung ausgesetzt. Der Einsatz innovativer Technologien ist ein wichtiger Hebel zur Begegnung dieser Herausforderungen. Die Technologie MID (Molded Interconnect Devices) bietet in diesem Zusammenhang viel versprechende neue Möglichkeiten, die von Experten der Szene kontrovers diskutiert werden. Die MID-Studie 2006, die das Heinz Nixdorf Institut im Auftrag der Forschungsvereinigung 3-D MID e.V. durchgeführt hat, gibt einen Überblick über die Marktverbreitung sowie über die Investitionsverhalten von Unternehmen. Es werden Chancen und Barrieren bei der Durchführung von MID-Projekten analysiert.

MID-Teile sind räumliche Spritzgussteile, die elektronische und mechanische Funktionen integrieren. Die Oberflächen der Spritzgussteile können partiell metallisiert werden. So entstehen Leiterbahnen, auf denen elektronische Bauteile gelötet oder mit Leitleber befestigt werden. Die Metallisierungen lassen sich aber auch so gestalten, dass sie als Schirmungen, Wärmebrücken oder Antennen genutzt werden können. Mechanische Funktionen wie Schnappverbindungen werden durch die Form des Kunststoffteils realisiert. Wesentliche Vorteile der Technologie MID sind die hohe Funktionsdichte, eine Reduzierung der Teilezahl und die räumliche Gestaltungsfreiheit.

Das hohe Nutzenpotential der Technologie ist offensichtlich. Viele Unternehmen haben das erkannt und setzen MID erfolgreich ein. Andere Unternehmen beobachten die Technologie und warten, bis auch die letzten Barrieren abgebaut sind. Bisher fehlte es an verlässlichen Daten, die einen Überblick über die Marktverbreitung sowie über die Bedeutung der noch vorhandenen Barrieren geben. Die MID-Studie 2006 gibt hier Aufschluss. In der Marktanalyse haben wir die aktuelle und zukünftige Verbreitung der Technologie analysiert. Daraus lassen sich Schlüsse über die Verbreitungsdynamik ziehen. In der Analyse von

Text mit einem Bild:
max. 4000 Zeichen
inkl. Leerzeichen

Die Markt... deutschen MID-Marktes. Es werden das Marktvolumen und dessen Entwicklung im Zeitraum 2004 bis 2008 bestimmt. Darüber hinaus werden konkrete Aussagen über Keyplayer, Branchen, realisierte Produktfunktionen und Herstellverfahren getroffen. Die Höhe der Investitionen von Unternehmen in die Technologie MID wird bestimmt und nach Art der Investitionen aufgeschlüsselt.

Das sind die Kernaussagen:

- Die MID-Hersteller haben innovative Produkte in der Planung. Es deutet alles auf neue MID-Erzeugnisse in den kommenden Jahren hin.
- Der Markt für Auftragsfertigung wächst stark.
- Hohe Investitionsquote bringt notwendigen Impulse.

Bisher erfüllt die Technologie MID alle Kriterien einer Schrittmachertechnologie. Für spezielle Anforderungsprofile gibt es erfolgreiche Serienanwendungen. Verglichen mit den hohen Potentialen der Tech-

nologie, ist der endgültige Durchbruch aber noch nicht erreicht. Wir haben deshalb analysiert, welche Barrieren die Durchführung von MID-Projekten behindern.

Die höchste Bedeutung haben die allgemeinen Barrieren. Beispielsweise gibt es noch zu wenig MID-Hersteller auf dem Markt. Die

Bild:
Format tiff oder cdr, 300dpi



Cover der MID-Studie 2006

Bildunterschrift

psychologischen und technologischen Barrieren sind dagegen zum großen Teil gering. Eine gesonderte Befragung von MID-Entwicklern hat ergeben, dass für sie insbesondere die Beherrschung der Komplexität von MID-Bauteilen eine besondere Barriere darstellt. Änderungen des Produktmodells in der einen Domäne ziehen oft weit reichende Änderungen in anderen Domänen nach sich. Das könnte ein Grund dafür sein, dass die bisher realisierten Serienanwendungen zum großen Teil relativ einfach sind. Darüber hinaus kämpfen die Entwickler mit den Restriktionen durch die Fertigungstechnologien. Hier spielt die Aufbau- und Verbindungstechnik eine zentrale Rolle. Sie bildet immer wieder den Flaschenhals für neue Produktkonzepte.

Prof. Dr.-Ing. Jürgen Gausemeier, Dipl.-Wirt.-Ing. Thomas Peitz, Produktentstehung, Heinz Nixdorf Institut, Universität Paderborn

Kontakt Daten

Freigabeerklärung. Berliner Kreis Newsletter

Absender

Name des Autors und Lehrinstituts

Antwort

Heinz Nixdorf Institut
Redaktion BK-Newsletter
Christoph Peitz

FAX +49 (0) 5251 / 60-6268

Freigabeerklärung

Hiermit erkläre ich, dass der von mir verfasste Artikel
für den Berliner Kreis Newsletter:

Name/ Überschrift des Artikels

auch in folgenden Publikationen veröffentlicht werden darf:

- Konstruktion. Zeitschrift für Produktentwicklung
& Ingenieurwerkstoffe
- ZWF - Zeitschrift für wirtschaftlichen
Fabrikbetrieb

Datum/ Unterschrift des Autors